

# 北京国化新材料技术研究院有限公司文件

## 关于召开“2026 硅树脂技术创新与应用交流会” 的预通知

### 各有关单位：

当前，全球新材料产业正向高性能、绿色化与高附加值方向加速转型。硅树脂作为有机硅体系中的高端材料，凭借优异的耐高低温、电气绝缘、耐候疏水及光学透明等特性，在航空航天、半导体封装、新能源汽车、光学器件及特种涂层等战略新兴领域中作用日益关键。然而，我国高端硅树脂长期面临合成工艺壁垒高、关键牌号依赖进口、应用基础研究薄弱等问题。随着 5G/6G 通信、高功率器件、智能汽车及高端涂装技术快速发展，耐高温甲基苯基硅树脂、高折光率 LED 封装胶、光学级有机硅增粘剂及有机硅杂化涂层等国产化需求尤为迫切。

为加快突破高端硅树脂合成改性技术瓶颈，我院拟定于 2026 年 10 月 27-29 日在深圳举办“2026 硅树脂技术创新与应用交流会”，设立“高端硅树脂合成改性与国产化替代”、“高端电子与光学级有机硅树脂”、“新能源与特种涂层”三大分论坛。报名本会，可免费参加“2026 华南硅业大会及展览会”的 5 个配套会议，具体通知如下：

### 一、组织机构

支持单位：中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会、硅产业绿色发展联盟 SAGSI、中关村光伏产业联盟 ZPVA、云南省硅工业工

程研究中心

主办单位:北京国化新材料技术研究院

承办单位:ACMI 硅基新材料研究所

支持媒体:有机硅、气凝胶产业、ACMI 硅基新材料、ACMI 光伏新材料、国化新材料研究院、化工新材料、硅产业绿色发展联盟官网

## 二、暂定日程

(一) 时间地点:

会议时间: 2026 年 10 月 27-29 日

会议地点: 广东深圳

会议场地: 深圳登喜路国际大酒店

场地地址: 深圳市宝安区西乡街道宝田一路 12 号

(二) 会议议程:

10 月 27 日全天 参展、安排班车	第六届深圳氟硅材料高端应用展览会 2026 深圳国际薄膜与胶带展 时间地点: 2026 年 10 月 27-29 日 深圳会展中心
10 月 27 日全天	注册、签到
10 月 28 日上午	大会主论坛
10 月 28 日下午	主题一: 高端硅树脂合成改性与国产化替代
10 月 29 日上午	主题二: 高端电子与光学级有机硅树脂
10 月 29 日下午	主题三: 新能源与特种涂层

报名本会 免费参加同期 展会、会议	2026 华南硅业大会及展览会： 1、2026 硅橡胶技术创新与应用发展峰会； 2、2026 纳米二氧化硅材料技术与应用交流会； 3、2026 先进硅基陶瓷技术与应用交流会 4、2026 第四届硅基气凝胶生产及应用高峰论坛
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 三、收费标准

#### (1) 参会费用

日期	9 月 15 日	10 月 15 日	10 月 15 日后
价格	2800 元/人	3000 元/人	3200 元/人

三人及以上团体再优惠 200 元/人。学生半价。费用含会议费、餐饮（中餐和晚餐）及其它杂费。住宿统一安排，费用自理。

#### (2) 展位费用

展位类型	价格	备注
展板展位	18000 元/个	1、展板尺寸 2.2 米（宽）*3 米（高）， 配套一张展桌，两把椅子； 2、赠送参会名额 2 人；

#### (3) 账户信息

户 名：北京国化新材料技术研究院有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行

账 号：0200 2282 0902 0125 456

汇款请注明“硅树脂会议”

#### (4) 商务合作

会议接受赞助发言、展位、手册广告、挂绳、胸卡、易拉宝、客户对接等各类商务合作，详询会务组。

#### 四、联系方式

张 慧 17352637513 zhanghui@acmi.org.cn

徐静涛 13916891739 xujingtao@acmi.org.cn

唐乃美 18210097596 tangnaimei@acmi.org.cn

附件 1：参会回执表

附件 2：分论坛及暂定议题

北京国化新材料技术研究院有限公司

二〇二〇年四月三十日



## 附件 1:

## 参会回执表

会议名称后打✓	2026 硅树脂技术创新与应用交流会			
企业* (发票抬头)				
经营产品	(限添 3 种, 将录入通讯录中)			
通讯地址*				邮 编
参会代表	姓 名	职 务	手 机	电子邮箱
详细信息*				
参会费用	日期	9 月 15 日前	10 月 15 日前	10 月 15 日后
	价格	2800 元/人	3000 元/人	3200 元/人
	❖ 三人及以上团体再优惠 200 元/人。学生半价。 __万__仟__佰__拾__元 ¥: ____元 (含会费、餐饮, 不含住宿, 汇款注明: 硅橡胶会议)			
付款方式	户 名: 北京国化新材料技术研究院有限公司 开 户 行: 中国工商银行股份有限公司北京中航油支行 账 号: 0200 2282 0902 0125 456 汇款请注明“硅树脂会议”			
住宿信息*	1、深圳登喜路国际大酒店(准五星), 深圳市宝安区宝田一路 12 号, 0755-23008888, 豪华大床 480 元/天(含早), 豪华双床 500 元/天(含早) 2、深圳嘉禧国际酒店, 深圳宝安宝田一路地铁站点, 距会议酒店 60 米, 单间/标间 350 元/天含早 (签到时间 10 月 27 日, 会议时间 10 月 28-29 日) 住宿时间: __月__日至__月__日 共__天, 单间__间, 标间__间, 因会议人数较多, 房间有限, 会务组仅为付费代表提前预留房间, 房费请与酒店直接结算; 留房截止日期 10 月 15 日; 未支付会议费的代表, 住宿请自行安排。			
会务组	张 慧 17352637513 zhanghui@acmi.org.cn 徐静涛 13916891739 xujingtao@acmi.org.cn 唐乃美 18210097596 tangnaimei@acmi.org.cn			
提示: *为必填项; 参会单位请把报名表 Email 至会务组(以上一人即可), 以便制作通讯录等资料; 发票种类(打✓): 电子专票____; 电子普票____。 开票资料:				

## 附件 2：分论坛及暂定议题

### 开幕式及主论坛

#### 1、嘉宾致辞

主办方及联合会领导致辞

国际相关行业组织代表致辞

大会主要赞助单位代表致辞

#### 2、主旨报告

院士作前沿技术报告

国家产业主管部门及行业协会专家解读政策

全球龙头企业负责人分享产业实践

著名经济专家分析宏观形势与市场前景

#### 3、嘉宾巡展

领导、院士及与会嘉宾巡视展区

## 主题一：高端硅树脂合成改性与国产化替代

国产高端有机硅封装材料的产业化瓶颈与技术路径分析

低羟基甲基 MQ 硅树脂分子设计与制备工艺优化策略

新型 AMQ 树脂的合成途径与对硅橡胶力学性能的综合评价

硅酸钠法甲基含氢封端硅树脂绿色制备技术与产业化推广

分子模拟指导下化学接枝改性硅树脂的低温热稳定性提升方案

超高纯硅酸酯技术突破助力国产半导体 CMP 材料全面替代

高分子量 MQ 硅树脂制备创新与工业应用进展

超低羟基含氟硅树脂的表面疏水性与化学稳定性协同调控研究

原位聚合法丙烯酸酯-有机硅复合硅脂多相体系难相容问题的解决方案

非贵金属光催化环四硅氧烷 C-H 官能化用于硅树脂绿色可持续合成

新型苯基改性聚硅氧烷核壳乳液的合成与水性化工涂料应用

含巯基官能团的聚倍半硅氧烷合成及金属防腐蚀长效涂层研发

环氧杂化 MQ 硅树脂的分子构建及对压敏胶粘接性能的增韧补强机制

中低温固化水性耐高温硅树脂涂料的配位催化体系与热稳定性

MQ 硅树脂 M/Q 比精准控制及其对光学压敏胶力学-交互平衡的影响研究

连续式微通道反应器及智能化产线在高品质硅树脂生产中的创新应用

低表面能 MQ 树脂与含氢硅油协同构筑新型高温聚氨酯发泡异氰酸酯体系

用泡沫稳定剂

含  $\text{TiO}_2$  与  $\text{SiO}_2$  的有机硅-无机杂化自修复涂层的耐候性与长效机理

室温湿气快速固化的超支化聚硅氮烷树脂在重防腐金属界面的应用

## 主题二：高端电子与光学级有机硅树脂

全球封装级有机硅材料市场现状与高端化发展趋势

有机硅凝胶在第 7 代 IGBT 模块中的耐高温与应力缓冲技术

碳化硅功率器件高温封装用有机硅树脂的系统解决方案

半导体先进封装用低应力有机硅凝胶的应力吸收机制与热循环可靠性

有机硅导热灌封胶在新能源汽车功率半导体模块热管理中的填料网络设计

超纯 MQ 硅树脂在半导体封装中的金属杂质控制与电绝缘性能优化

耐电子腐蚀氟硅树脂在严苛环境电子组件防护中的应用

高导热有机硅灌封材料在电动汽车牵引逆变器中的应用

有机硅树脂基介电材料在先进封装 RDL 重布线层中的应用前景

5G 功放器件用纳米复合导热有机硅灌封胶的热管理优化

高速光模块 PCBA 用硅树脂三防保护涂层的防水防潮与介电防护方案

光电子器件用高透明、低折射率有机硅防护胶的配方设计与工艺控制

数据中心光模块多通道散热瓶颈的有机硅热管理材料系统方案

大功率 LED 封装中硅树脂替代环氧树脂的光效提升与寿命延长机制

超薄折叠屏铰链密封用柔性硅树脂的抗疲劳与防尘设计

高折光率苯基硅树脂在倒装芯片 LED 封装中的应用

高透 MQ 硅树脂在 LED 透镜中的精密注塑成型工艺与耐候性突破

高分子量 MQ 硅树脂的连续化合成技术突破与工业化进展

MQ 硅树脂在有机硅压敏胶中的补强机制与增粘协同效应

有机硅树脂在电子元器件的阻燃、绝缘与热管理综合解决方案

### 主题三：新能源与特种涂层

硅树脂基相变复合材料在动力电池热管理中的被动散热与储能效应

新能源动力电池模组用超薄型硅树脂隔热涂料的防火性能研究

充电枪与高压连接器用耐高温、耐候硅树脂密封护套材料

高压直流继电器与车载电源用高抗电化学腐蚀有机硅灌封树脂高比

有机硅封装胶在光伏接线盒与逆变器中的耐候性研究

有机硅隔热灌封材料在储能电池模组中的应用

有机硅导热灌封胶在集装箱式储能系统热管理中的选型与失效分析

光伏电站公辅设备用硅树脂三防漆的防盐雾与防腐蚀性能

全球船舶防污涂料市场现状与有机硅基污损释放型涂料的发展机遇

纳米增强硅树脂防污涂层：力学性能提升与防污寿命延长策略

氟硅树脂改性防污涂层：低表面能与抗蛋白吸附的双重防污效应

硅树脂防污漆施工工艺的关键问题研究

静态浸没条件下的防污瓶颈：船舶静止期有机硅涂层的污损控制策略

基于有机硅微胶囊的自修复防污涂层：损伤修复与防污剂控释技术

海洋工程设施用有机硅防污防腐一体化涂层技术

国内有机硅防污漆产业化进展与替代国际品牌的技术差距分析

航空航天用耐超高温苯基硅树脂的生产工艺与低温固化应用研究

氟硅树脂改性聚合物在航空发动机耐油耐溶剂管材密封件中的应用

硅树脂基耐辐射涂层在太空环境下的稳定性研究

新型有机硅纳米树脂在耐涂鸦、易清洁及表面防污自修复涂料中的机理研究

环保型硅树脂在电子元器件封装涂敷中的低挥发与高可靠性优势分析